

2008年度第2回「(東大阪)表面処理加工技術研究会」のご案内

1. 日時：2008年7月28日(月) 15時-17時
2. 場所：クリエイション・コア東大阪南館3階研修室B, C室
3. 主催：表面処理加工技術研究会、共催：大阪産業振興機構、龍谷大学REC
4. 議題：表面処理技術加工による機械的特性の改善

(15:00-16:00)

(1) 「DLC膜に関する研究紹介」

- ①DLC膜の密着性向上のための前処理手法の検討
- ②DLC膜へのSi添加による熱酸化安定性の向上
- ③DLC膜/潤滑油界面の構造解析 他

同志社大学 准教授 平山 朋子 氏

(16:00-16:15)

(2) 「企業紹介 株式会社 ケンテック」

(株)ケンテック 社長 川端 健一 氏

(16:15-16:30)

(3) 「新メンバーの自己紹介」(2008年度初参加メンバーの概要を紹介下さい)

(16:30-17:00)

(4) 参加メンバーによる機械的性質改善へのニーズ検討の紹介と討議(機械的性質改善へのニーズ、シーズ等を気軽にお話戴きたく)

尚、研究会に引き続き、軽食を肴に交流会を予定していますので、是非ご参加下さい。

(会費 500円)

以上